



보도자료 문의:

Stephen Brennan, MCA

Phone: 650/968-8900, ext. 114

Email: sbrennan@mcapr.com

전세계 19 개 전자업체 SOI 산업 컨소시엄 구성

다양한 시장으로의 SOI 기술 확대 가속화
SOI 산업 컨소시엄, 비용 절감 목표로 신시장 진출

2007년 10월 9일 매사추세츠 보스턴 – 전세계 전자 업계의 굴지 기업들이 그룹을 형성하고, SOI 산업 컨소시엄(SOI Industry Consortium)을 공식 출범한다고 밝혔다. 이 컨소시엄은 SOI 기술의 이점을 널리 알리고, 기술 적용의 장벽을 낮춤으로써 다양한 시장에서의 SOI(silicon-on-insulator) 기술 혁신을 가속화하는 것을 목표로 삼고 있다.

성능 및 소비전력은 이제 전세계 전자업계에서 가장 기본적인 관심사항이 되었다. 일찍이 SOI를 받아들인 기업들은 SOI가 이러한 문제를 해결할 수 있는 강력한 솔루션이라고 설득력 있는 주장을 하면서 자신들만의 솔루션을 개발해 왔다. 앞으로 이 기술 사용자들이 필요로 하는 것은 투명한 설계 플랫폼 및 비용 효과적인 제조를 위해 업계에서 입증되고, 바로 액세스 가능한 완벽한 SOI 설계 플랫폼과 IP이다. SOI 컨소시엄은 비용 절감, SOI 성공 사례 제공, 가치사슬에서의 설계 표본 개발 촉진을 통해 이론과 현실의 차이를 극복하는 것에 중점을 두고 있다.

이 컨소시엄의 창립 멤버는 사용자, 이네이블러(enabler), 공급업체 및 제조업체들로 구성되어 있으며, 참여 업체는 다음과 같다(알파벳 순서로 나열): AMD, ARM, 케이던스(Cadence Design Systems), CEA-Léti, 차터드 세미컨덕터(Chartered Semiconductor Manufacturing), 프리스케일(Freescale Semiconductor), IBM, 이노베이티브 실리콘(Innovative Silicon), KLA-Tencor, 램리서치(Lam Research), NXP, 삼성(Samsung), 세미코(Semico), 소이텍(Soitec), SHE Europe, ST 마이크로(STMicroelectronics), 시놉시스(Synopsys), TSMC 및 UMC.

새롭게 선출된 앙드레 자크 오베르통 에르베(André-Jacques Auberton-Hervé) SOI 컨소시엄 회장은 "SOI는 업계에서의 '성능 물결'을 타고 거대한 진출을 이루게 되었다"며 "이제 핵심은 소비전력 감소로까지 확대되었다. SOI는 소비전력을 대폭 줄일 수 있으며, 이는 소소한 것(휴대폰을 통해 재미있는 경기의 마지막 부분까지 볼 수 있도록 배터리가

충분히 남아있기를 바라는 것)에서부터 대규모(데이터 센터 운영)에 이르기까지 커다란 이점으로 작용한다. SOI 산업 컨소시엄은 사용자와 이네이블러를 통일시킴으로써 설계 사슬에서의 격차를 이해하고 좁힐 수 있으며, 이로써 더욱 다양한 분야에서 SOI가 설계자들에게 유용한 선택안이 될 것"이라고 말했다.

SOI 산업 컨소시엄은 다음과 같이 3가지를 목표로 하고 있다.

- 사용자의 요구사항에 귀 기울이고, 이해하며, 이를 해결할 수 있도록 한다
- 에코시스템에서 꼭 필요한 협력을 가속화 및 촉진함으로써 실리콘 검증 솔루션을 제공할 수 있도록 한다.
- 대규모 전자업계 내에서 SOI의 이점, 기술 혁신, 모멘텀을 널리 홍보한다.

가트너(Gartner)의 브라이언 레wis(Bryan Lewis) 반도체 리서치 부분 부사장은 “현재 SOI의 이점은 이 분야의 주요 업체들 대부분이 인정하고 있으며, 이 기술은 주류 속하기 시작했다”며 “반도체 업체들은 시간과 자본을 투자해 SOI를 다음 단계로 발전시키려 하고 있으며, 이는 분명 다양한 분야의 디바이스와 애플리케이션에서 전력 소모를 낮추고 성능을 높이는 발전을 촉진시킬 것”이라고 말했다.

이 컨소시엄은 우선 조기 기술 도입 업체들이 달성한 성공 사례들을 공유하고, 성능, 전력 및 면적과 관련해 SOI의 이점을 입증할 수 있는 새로운 설계 증거 사례들을 개발하는데 집중할 계획이다. 컨소시엄 이사회는 10월 말 경에 선출될 예정이다.

SOI 산업 컨소시엄 소개

SOI 산업 컨소시엄은 SOI(silicon-on-insulator) 기술의 이점을 널리 알리고, 기술 도입의 장벽을 낮춤으로써 더욱 다양한 분야에서 혁신적인 SOI가 적용될 수 있도록 하는 중대한 역할을 담당한다. SOI 산업 컨소시엄의 창립 멤버들은 AMD, ARM, Cadence Design Systems, CEA-Léti, Chartered Semiconductor Manufacturing, Freescale Semiconductor, IBM, Innovative Silicon, KLA-Tencor, Lam Research, NXP, Samsung, Semico, Soitec, SEH Europe, STMicroelectronics, Synopsys, TSMC 및 UMC와 같이 업계 굴지의 기업들로 구성되어 있다. 이 컨소시엄은 전자 관련 모든 업체 및 기관에 문을 열어 놓고 있으며, 자세한 정보는 www.soiconsortium.org 참조.

안전항구

SOI 산업 컨소시엄, 이 컨소시엄의 프레젠테이션 및 다른 커뮤니케이션을 통한 SOI 산업 컨소시엄 관계자가 표명한 전망과 견해들은 각 개인 멤버들의 의견을 반드시 대표하지 않는다. SOI 산업 컨소시엄의 관계자들은 컨소시엄을 대표해 발언하지만, 멤버들의 회사나, 관계자들과 관계 있는 회사들의 의견을 대변하기 보다는 SOI 산업 컨소시엄의 견해를 대변한다고 볼 수 있다. 견해와 의견들은 공지, 커뮤니케이션, 및 수반되는 논의 없이 변경될 수 있으며, SOI 산업 컨소시엄은 커뮤니케이션 및 수반되는 논의에 대한 업데이트를 할 의무가 없다.

###



SOI 산업 컨소시엄 창립 위원 인사말

AMD

"SOI 는 AMD 에게 중요한 플랫폼을 제공하여 다양한 고성능 및 저전력 마이크로프로세서를 구축할 수 있도록 한다. AMD 는 SOI 가 제공하는 고유의 성능 조화 및 전력 소모 감소를 통해 x86 제품 분야에서의 선두 자리를 지키고 있다"

-- 우도 노더퍼(Udo Nothefer) AMD Fab36 부사장

보도자료 문의: Gray Silcott, gray.silcott@amd.com

ARM

"ARM 은 프로세서 및 physical IP 분야의 선도업체로서 전력 효율이 가장 높은 제품을 개발하는데 주력해 왔다"며 "머지않아 곧 SOI 가 반도체 업계에서 널리 사용될 것으로 믿고 있다. ARM 은 SOI 컨소시엄 참여를 통해 고객업체들이 관련 기술을 더욱 신속히 받아들일 수 있도록 지원할 것이다."

-- 톰 란츠쉬(Tom Lantzsch) ARM Physical IP 마케팅 부사장

보도자료 문의: Nandita Geerdink, Text 100, 415-593-8457, naarm@text100.com
Claudia Natalia, ARM, 408-548-3172, claudia.natalia@arm.com
Steve Taylor, ARM, +44 (0) 1223 406 025, steve.taylor@arm.com

Cadence

"설계 기술은 SOI 산업에서 매우 중요한 부분이며, 케이던스 제품은 많은 성공적인 SOI 설계에 사용되어 왔다. EDA 분야의 리더이자 SOI 컨소시엄 멤버로서 케이던스는 고객들의 차세대 SOI 설계를 지원하고, SOI 산업의 기술 혁신을 가속화 할 수 있기를 기대한다."

-- 크레이그 존슨(Craig Johnson) 케이던스 마케팅 전략 부사장

보도자료 문의: Michael Fournell, Cadence, 408-428-513, fournell@cadence.com

CEA-Léti

"CEA-LETI 는 '스마트 컷(Smart Cut™)' 기술 개발과 주요 SOI 설계 혁신의 근거지이자 차세대 SOI 회로기판에서의 CMOS 및 RF 리서치 분야의 선두주자로서, 전세계 선도업체들과 함께 SOI 컨소시엄에 참가하여, 첨단기술의 확장을 위해 우리가 지닌 SOI 에 대한 전반적인 가치사슬의 전문성을 제공하고자 한다."

-- 로랑 마리어(Laurent Malier) CEA-LETI CEO

보도자료문의: Marie-Noelle Semeria, marie-noelle.semeria@cea.fr

Chartered

"오늘날 업계를 움직이고 있는 최종 시장은 경영능력, 성능 및 비용 면에서 새롭고 혁신적인 방식을 요구하고 있다. SOI 는 컴퓨터 및 게임 애플리케이션용 전력과 성능 비율의 발전에 촉매제이자 차터드(Chartered)의 파운드리 사업의 성장 엔진

역할을 해왔다. 이번 컨소시엄의 창단 멤버로서 차터드는 최종시장의 요구를 충족시켜야 한다는 복잡한 과제를 풀기 위해 비슷한 혁신을 요하는 다른 시장에까지 SOI 가치명제의 범위를 확장시킬 방안을 모색 중이다.”

-- 케빈 메이어(Kevin Meyer) 차터드 세미컨덕터 산업 마케팅 & 플랫폼 얼라이언스 부사장

보도자료 문의: Tiffany Sparks, Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., 408-941-1185, tiffanys@charteredsemi.com

Freescale

“프리스케일(Freescale)은 다년간 자사의 프로세서 로드맵에서 SOI 기술을 도입하는데 앞장서왔다. SOI 컨소시엄 출범은 보드 기반 애플리케이션 분야에서 SOI 기술 도입의 확대를 도울 것이다. 이로써 더 많은 최종 이용자들이 이 기술의 내재가치인 시스템 레벨에서 중심적인 기능을 지속적으로 향상시킴과 동시에 전력 소모를 줄일 수 있는 방법을 통해 이익을 얻을 수 있을 것이다.”

-- 리사 수(Lisa Su) 프리스케일 세미컨덕터 CTO

보도자료 문의: Andrew North, Freescale Semiconductor, 512-203-7169, andy.north@freescale.com

IBM

“IBM은 산업 선두주자들 간의 협동을 장려하고 열린 커뮤니티를 발전시키기 위해 우리의 기술을 공유하며 오랫동안 헌신해왔다. 우리는 우리의 시스템 리더십에 중요한 부분을 차지해 온 SOI가 보드셋 애플리케이션 분야에서 게임 변화자가 될 것이라 믿고 있다. IBM은 최초의 45nm ASIC에서부터 최신 130nm RF 같은 새로운 OEM 제품을 시장에 제공함으로써 SOI에 대한 수요를 충족시켜 왔다. 우리는 SOI의 주요 성능과 전력 속성을 활용함으로써 보드 분야에 SOI 기술 도입이 확대될 수 있도록 지원할 수 있기를 고대하고 있다.”

-- 마크 아일랜드(Mark Ireland) IBM 반도체 플랫폼 부사장

보도자료 문의: Catherine Helzerman, GES Communications Manager, 408-677-9813, cahelzer@us.ibm.com

Innovative Silicon

“ISi는 SOI 산업 컨소시엄의 창립 멤버가 된 것을 자랑스럽게 생각한다. Z-RAM 메모리 IP와 같은 SOI 기반 디바이스는 벌크 CMOS에 비해 우수한 전력, 성능, 집적도 및 비용 이점을 제공한다. 업계 선도업체들로 구성된 이 컨소시엄은 조만간 SOI 설계 및 기술이 주류를 형성할 수 있도록 할 것이다.”

-- 제프 루이스(Jeff Lewis) 이노베이티브 실리콘 마케팅 부사장

보도자료 문의: Rick Gaan, rgaan@z-ram.com

KLA-Tencor

“SOI의 빠른 성장은 모든 종류의 반도체 설계를 위한 주요 성능 및 효율적인 이점들을 보장해 준다. 이 컨소시엄을 통해 향후 여러 차세대 칩에 걸쳐 SOI 기술의 검사 및 방법과 관련한 기술과제를 이해하고 해결하는 것은 물론, SOI 기반의 디바이스를 사용하거나 사용할 계획을 가진 모든 칩 업체들이 수율 면에서 많은 이점을 얻을 수 있을 것이다.”

-- KLA-Tencor, 브레인 트라파스(Brain Trafas) CMO

보도자료 문의: Charlie Lewis, KLA-Tencor, Charles.Lewis@kla-tencor.com

Lam Research

"SOI는 우리의 고객업체들이 고성능 제품을 제공할 수 있도록 도와주는 매우 중요한 기술이다. 램은 SOI 웨이퍼 집적 및 공정과 관련하여 앞으로 제기될 문제들에 대해 이해하고자 이 컨소시엄에 참가했다. 이 컨소시엄 참가를 통해 램은 웨이퍼 팹에서 문제점이 발생하기 전에 먼저 관련 솔루션을 고객에게 제공할 수 있도록 계속 전념할 수 있을 것이다. SOI 컨소시엄에 참가함으로써 SOI 기술 분야에서 선도적인 위치를 확보하고, 그 역할을 성공적으로 이행하기 위한 모든 요구 조건에 부합할 것이다."

-- 리처드 고트쇼(Richard Gottscho) 램리서치, 에칭 사업부 그룹 부사장 & 재너럴 매니저

NXP

"SOI 기술의 대부 격이자 오랫동안 사용해온 경험자로서 NXP는 관련 기술을 발전시킴과 더불어 새로운 애플리케이션을 개발할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. SOI 컨소시엄은 이러한 새로운 연구개발을 촉진하고 구체화 하기 위한 플랫폼을 제공한다."

-- 데렉 월래스(Derek Wallace) NXP 세미컨덕터 부사장 및 CPO(Chief Purchasing Officer)

보도자료 문의: Lieke de Jong-Tops, lieke.de.jong-tops@nxp.com

Semico

"세미코는 SOI 산업 컨소시엄의 창립 멤버가 된 것을 자랑스럽게 여기고 있으며, 떠오르고 있는 혁신적인 기술에 대한 선견지명을 가진 것에 대한 자부심도 지니고 있다. 세미코 리서치의 짐 필드한(Jim Feldhan) 사장은 "3년 전 세미코는 SOI 기술이 반도체의 성능 및 저전력 애플리케이션 분야 모두에서 발전을 가져올 기술이라는 것을 예측했다. 오늘날 이 기술은 여러 양산 애플리케이션에 적용이 됐다. 그 동안 일반적으로 벌크 CMOS를 사용해 왔던 애플리케이션까지도 SOI를 차세대 설계로 검토하고 있어 미래에 대한 전망 또한 밝다."

-- 짐 필드한(Jim Feldhan) 세미코 리서치(Semico Research Corp) 사장

보도자료 문의: Jim Feldhan, jimf@semico.com

Soitec

"SOI가 20여년전 처음으로 선보인 이래 계속해서 이에 대한 믿음을 가져온 사람 중에 하나로서, SOI 산업 컨소시엄 출범은 매우 흥분되는 순간이다. 이 컨소시엄 구성은 최종 사용자의 수요에 힘입은 것으로, 회로 설계 및 기판 엔지니어링에서부터 제조, 패키지 및 시스템 통합에 이르기까지 모든 분야를 아우른다. 우리는 이들 각 단계에서 SOI가 어떻게 성능과 기능성을 향상시키고 전력소비와 비용을 줄일 수 있는지를 보아왔다. 업체들간의 협력을 통해 성공 사례들을 공유하고, 더 큰 전자 업계의 커뮤니티로 뻗어 나가면서 신규 시장에 이러한 이점들을 제공, 모두의 이익을 꾀할 수 있을 것이다."

-- 앙드레 자크 오베르통 에르베(André-Jacques Auberton-Hervé)
소이텍 그룹 CEO 및 이사회장

보도자료 문의: Camille Darnaud-Dufour, Soitec, camille.darnaud-dufour@soitec.fr

STMicroelectronics

“ST 마이크로는 SOI 기술의 오랜 지지자로서 SOI가 지닌 이점의 경험 및 기술적 연구를 공유할 수 있는 플랫폼이 되어줄 SOI 컨소시엄을 강력히 지원한다.”

-- 마이크 톰슨(Mike Thompson)

ST 마이크로일렉트로닉스 프런트엔드 기술 및 제조,
차세대 R&D -고성능 로직 & 파생 제품 그룹 부사장

보도자료 문의: Michael Markowitz, 212-821-8959, michael.markowitz@st.com

Synopsys

“SOI는 성능 및 전력 소모 문제와 관련 된 중요한 기술로 자리 잡았다.

시놉시스(Synopsys)는 SOI 컨소시엄의 창립 멤버로서 전자 설계 및 IP 분야에서의 우리의 전문성을 제공하여 SOI가 주류가 될 수 있도록 도울 수 있기를 고대한다.”

-- 리치 골드만(Rich Goldman) 시놉시스 전략 시장 개발 부사장

보도자료 문의: Yvette Huygen, Synopsys, Inc., 650-584-4547, yvetteh@synopsys.com

TSMC

“TSMC는 파운드리 업계의 리더로서 모든 비용 효과적인 벌크 실리콘 기반의 기술 플랫폼을 제공, 고객들의 광범위한 제품 애플리케이션을 지원하고 있다. 업계에서 더 높은 성능 및 더 낮은 전력소비를 특징으로 하는 디바이스에 대한 수요가 늘어남에 따라 SOI는 업계가 평가해야 하는 트레이드오프와 함께 틈새 기술로 급부상 하고 있다. 컨소시엄의 창립 멤버로서 TSMC는 기존 및 잠재적인 SOI 애플리케이션 지원을 위해 기술 플랫폼 통합 및 양산 제조에 있어 가장 좋은 경험들을 제공할 수 있을 것이다.”

-- 푸치에 수(Fu-Chieh Hsu) TSMC 설계 및 기술 플랫폼 부사장

보도자료 문의: Chuck Byers / cbyers@tsmc.com

UMC

“SOI 산업 컨소시엄의 창립 멤버가 된 것을 영광스럽게 생각한다. 이러한 이니셔티브에 가담하여 SOI가 차세대 SOC에서 성능 향상 및 전력소비 감소를 위한 매력적인 솔루션으로 적용될 수 있도록 할 것이다. 이제 칩 설계자들이 UMC 고유의 SOI 기술을 이용할 수 있게 됨에 따라 앞으로 업계에서 SOI 사용이 더욱더 확대되기를 기대한다.”

-- 리 청(Lee Chung) UMC Se, UMC 기업 마케팅 부사장

보도자료 문의: Richard Yu, Richard_Yu@umc.com